

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 1 区分
 【発行日】平成 24 年 4 月 5 日 (2012.4.5)

【公開番号】特開 2009-238745 (P2009-238745A)
 【公開日】平成 21 年 10 月 15 日 (2009.10.15)
 【年通号数】公開・登録公報 2009-041
 【出願番号】特願 2009-48760 (P2009-48760)
 【国際特許分類】

H 0 5 B 33/10 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

【F I】

H 0 5 B 33/10

H 0 5 B 33/14 A

【手続補正書】
 【提出日】平成 24 年 2 月 20 日 (2012.2.20)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

第 1 の成膜用基板と、第 1 の電極を有する素子基板とを用い、
前記第 1 の成膜用基板は、透光性を有し、かつ、一方の面に、開口部を有する反射層と、
光吸収層と、前記反射層と前記光吸収層との間に設けられた断熱層と、前記光吸収層上に
湿式法を用いて形成した材料層と、を有し、
 前記素子基板の前記第 1 の電極が形成された面と、前記第 1 の成膜用基板の前記材料層が
 形成された面とを対向して配置し、
 前記第 1 の成膜用基板の前記第 1 の材料層が形成されていない側から周波数 10 MHz 以
上、パルス幅 100 fs 以上 10 ns 以下のレーザ光を照射し、前記光吸収層に接してい
る前記材料層を加熱し、前記材料層の少なくとも一部を前記素子基板の前記第 1 の電極上
に成膜する工程を有し、
 前記第 1 の成膜用基板を、他の材料層が形成された第 2 の成膜用基板と交換し、前記工程
 を繰り返すことで、少なくとも前記第 1 の電極上に、複数の層を形成することを特徴とす
 る発光装置の作製方法。

【請求項 2】

請求項 1 において、
 前記断熱層の前記レーザ光に対する透過率は 60 % 以上であり、かつ前記断熱層に用いる
 材料の熱伝導率は、前記反射層および前記光吸収層に用いる材料の熱伝導率よりも小さい
 ことを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項 3】

請求項 1 において、
 前記断熱層は、酸化チタン、酸化珪素、窒化酸化珪素、酸化ジルコニウム、炭化珪素のい
 ずれかを含むことを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項 4】

請求項 1 乃至請求項 3 のいずれか一において、
 前記反射層は、アルミニウム、銀、金、白金、銅、アルミニウムを含む合金、銀を含む合
 金、または酸化インジウム - 酸化スズのいずれかを含むことを特徴とする発光装置の作製

方法。

【請求項 5】

請求項 1 乃至請求項 4 のいずれか一において、

前記光吸収層は、金属窒化物、金属、カーボンのいずれかを含むことを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項 6】

請求項 1 乃至請求項 5 のいずれか一において、

前記材料層は有機化合物からなることを特徴とする発光装置の作製方法。